

株主の皆さまへ

第47期報告書

2024年4月1日から2025年3月31日まで



TOWA
キャラクター
トワッピー

トップメッセージ

平素は格別のご支援、ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2025年4月に取締役社長執行役員に就任いたしました三浦宗男でございます。

ここに、当社第47期報告書（2024年4月1日から2025年3月31日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当連結会計年度における世界経済は、インフレの落ち着きによる実質所得の持ち直しを背景に、底堅い成長を維持したものの、不動産不況や消費の低迷が続く中国経済の減速や、米国の通商政策など先行き不透明な状況が続きました。

半導体業界につきましては、生成AI関連を中心とした高性能な半導体向け投資は堅調に推移しましたが、PCやスマートフォンなどの民生品向けや産業機器向けにつきましては、最終需要の低迷や在庫調整の長期化により、投資の停滞が続きました。

このような状況のもと、当社グループの業績は、半導体内製化を推し進める中国や、地政学的リスクから活発な投資が続く東南アジアでの需要を獲得できたことから、売上高は前期比で増収となりました。各段階利益につきましては、人員増や研究開発費の増加にともない販売管理費が増加したものの、売上高の増加により、増益となりました。

今後とも、株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、グループ一丸となって邁進していく所存でございますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2025年6月

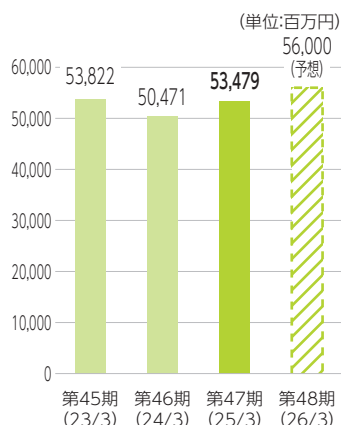


取締役社長執行役員

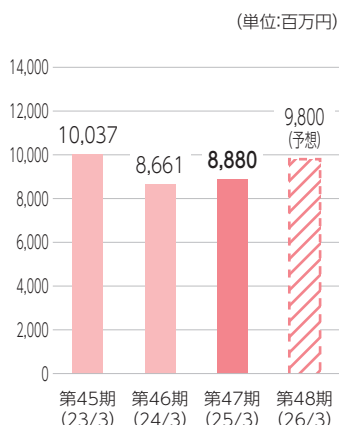
三浦宗男

業績ハイライト

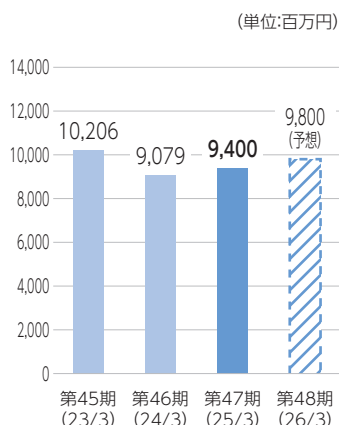
売上高



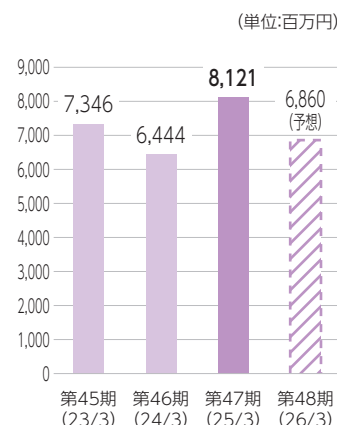
営業利益



経常利益



親会社株主に帰属する当期純利益





第二次中期経営計画

当社は、“新たな課題への挑戦と飛躍”を掲げた第二次中期経営計画（2026年3月期から2028年3月期まで）を2025年4月からスタートさせました。第一次中期経営計画で強化した基盤により、新たな課題へ挑戦し2032年の目標に向かって取組んでまいります。

第二次中期経営計画（2026年3月期～2028年3月期）の概要

テーマ：TOWAイズムで次世代をリードする人財を創出

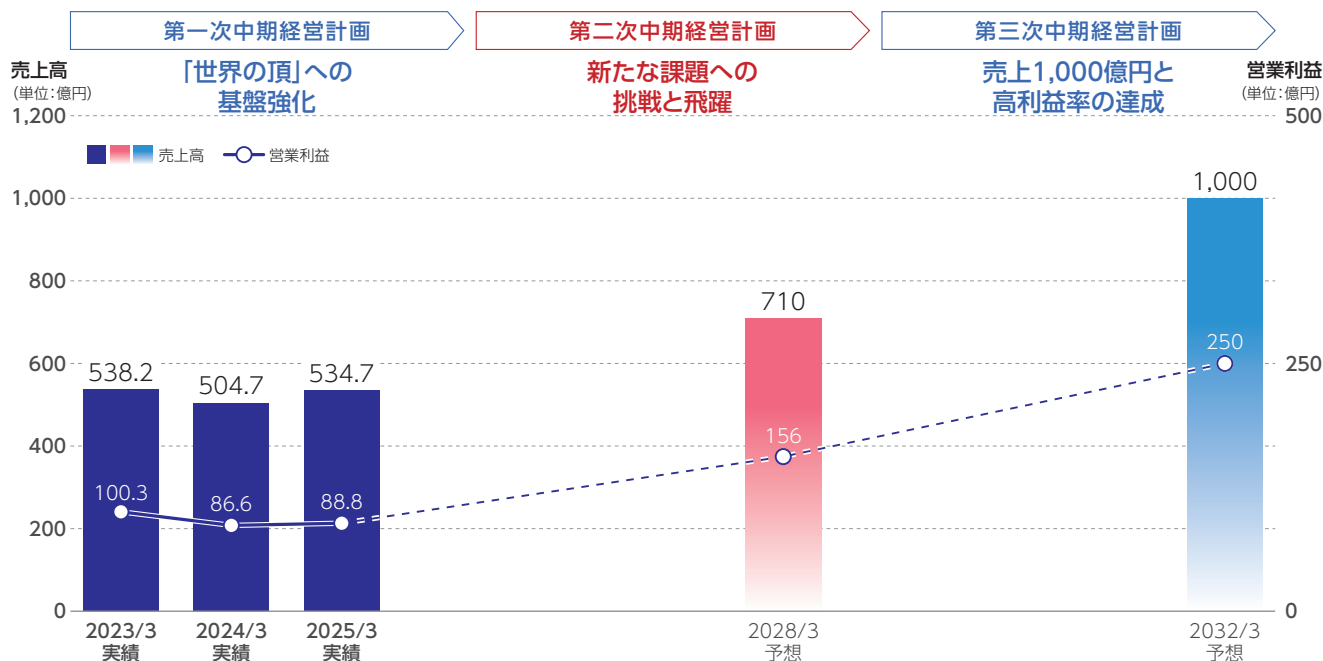
第二次中期経営計画 基本方針

- パラダイムシフトにより製品・サービスの付加価値を向上し収益力を高める
- DXとAIの活用によりスピード経営を実現し市場競争力を強化する
- コアコンピタンス*を活用し新たな市場を創り出す
- 多様性に富んだ挑戦思考を持ち次世代をリードする人財の育成を図る
- サステナビリティへの積極的な取組みにより社会貢献と企業価値の向上を図る

※他社に真似できない核となる能力。独自の強みや専門性など

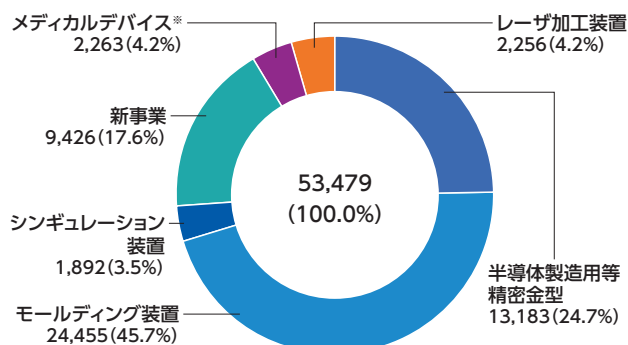
項目		期別	2028年3月期 (計画)
売上高	710	高	
売上高内訳	半導体製造装置事業		521
	メディカルデバイス事業*		28
	新事業		133
	レーザ加工装置事業		28
営業利益	156	益	
営業利益率	22.0%	率	
経常利益	156	益	
親会社株主に帰属する当期純利益	109		
R O E	13%以上		
株主還元	配当性向20%以上		

※ファインプラスチック成形品事業の名称をメディカルデバイス事業に変更いたしました。



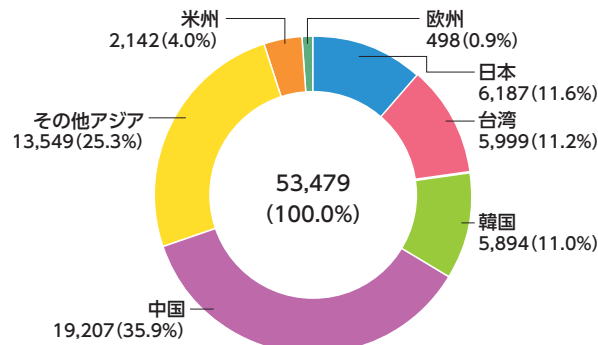
セグメント別連結売上高（第47期）

■製品別（単位: 百万円）



※ファインプラスチック成形品の名称をメディカルデバイスに変更いたしました。

■地域別（単位: 百万円）





さらなる成長を目指して

販売拠点の拡張 ▶ インドで子会社を設立

インド政府は、国家戦略として半導体産業の育成に注力しており、多数の大型投資計画が着実に進展しております。当社は、これまでシンガポールの販売子会社を通じてインド地域のサポートを行ってまいりましたが、今後益々加速するインドの半導体関連投資に対応すべく、2025年4月にインド・グルガオン市に新たな販売子会社を設立いたしました。

お客さまとの信頼関係を一層強固なものとするとともに、現地での事業基盤のさらなる強化を図ってまいります。将来的には、南アジアの新市場への進出を通じて、TOWAビジョン2032の実現に大きく寄与してまいります。



顧客リレーションの強化 ▶ 展示会での最新技術PR

超大判パネルモールド・カット技術の展示 ▶ SEMICON JAPAN

2024年12月11日から13日までの3日間、東京ビッグサイトで開催された「SEMICON JAPAN 2024」に出展し、生成AI・IoT向けPLP（パネルレベルパッケージ）技術をメインテーマに、先端パッケージに対する最新のモールドング技術やシングュレーション技術を紹介しました。当社のブースには、500名を超える方々にご来場いただき、当社の技術力と革新性を広く認知していただくことができました。



インド市場における知名度の向上 ▶ SEMICON INDIA



2024年9月11日から13日までの3日間、インド・デリー首都圏で開催された「SEMICON INDIA 2024」に初出展いたしました。

インド国内の主要企業や潜在顧客の皆さまに、ディスクリート等のレガシーパッケージや車載製品を中心に当社の技術をお伝えすることができました。

超撥水フィルムの初出展 ▶ 表面改質展

ハスの葉が雨に濡れると、雨滴がコロコロと転がっていきます。この現象は「超撥水」と呼ばれます。

当社は、この超撥水性を独自の表面改質技術で人工的に再現することができました。

2024年9月18日から20日までの3日間にわたり開催された「表面改質展2024」に初めて出展し、当社の表面処理技術を応用した超撥水フィルムを実演にて紹介いたしました。

ジェンダーダイバーシティ ▶ 女性活躍推進企業として「えるぼし」認定を取得

女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みが優良な企業として厚生労働省より「えるぼし（2段階目）」認定を受けました。

当社は、女性が活躍できる職場を作ることとを目的として、働きやすい環境を提供できるように力を入れております。男女を問わず、すべての従業員の人間性を尊重することで、企業の成長とイノベーションを促進し、社会全体の発展に貢献することを目指しております。今後も、女性を含むすべての従業員が能力を最大限発揮し、笑顔で働ける職場づくりに取り組んでまいります。





会社の概要 (2025年3月31日現在)

商 号 TOWA株式会社
(英文名TOWA CORPORATION)
設 立 1979年4月17日
資 本 金 8,969,261,572円
本 社 所 在 地 京都市南区上鳥羽上調子町5番地
☎ (075) 692-0250 (代表)
従 業 員 数 681名 (単体) 2,099名 (連結)
上 場 取 引 所 東京証券取引所プライム市場

役 員 (2025年7月1日時点)

代表取締役会長	岡 田 博 和
取締役社長執行役員	三 浦 宗 男
取締役専務執行役員	石 田 耕 一
取締役常務執行役員	柴 原 信 隆
取締役上席執行役員	西 村 一 洋
取締役執行役員	中 西 和 彦
社 外 取 締 役	矢 野 輝 弘
取締役常勤監査等委員	服 部 広 志
社外取締役監査等委員	和 氣 大 輔
社外取締役監査等委員	後 藤 美 穂
社外取締役監査等委員	田 中 素 子
常 務 執 行 役 員	鈕 方 舜
常 務 執 行 役 員	韓 相 倫
執 行 役 員	笹 田 秀 典
執 行 役 員	寺 内 利 浩
執 行 役 員	高 田 直 毅

株式の状況 (2025年3月31日現在)

●発行可能株式総数 240,000,000株
●発行済株式の総数 75,140,556株
●株主数 62,162名
●大株主

株主名	持株数	持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	5,753 (千株)	7.66 (%)
株式会社ケイビー恒産	5,700	7.59
株式会社エヌレガロ	3,780	5.03
株式会社京都銀行	2,099	2.80
株式会社日本カストディ銀行	1,798	2.39
JPモルガン証券株式会社	1,623	2.16
濱田 英之	1,286	1.71
楽天証券株式会社	1,127	1.50
TOWA社員持株会	934	1.24
JP MORGAN CHASE BANK 385781	849	1.13

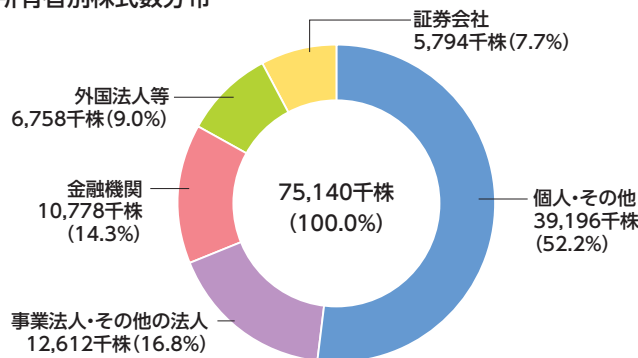
(注1) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の持株数は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式(43,275株)を控除して計算しております。

(注3) 2024年8月29日開催の取締役会決議により、2024年10月1日付で株式分割(1株につき3株に分割)に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、160,000,000株増加しております。

(注4) 2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。

■所有者別株式数分布



株主メモ

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年

定 時 株 主 総 会 毎年6月

基 準 日 株主総会権利行使及び期末配当 3月31日
中間配当 9月30日

単 元 株 式 数 100株

株 主 名 簿 管 理 人 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社

同 事 務 取 扱 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

郵便物の郵送先及び
電話お問い合わせ先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 ☎0120-288-324 (フリーダイヤル)

株主総会資料の電子提供
制度(書面交付請求)に
ついてのお問い合わせ先 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
☎0120-524-324 (電子提供制度専用フリーダイヤル)

未払い配当金のお支払 みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店
株式会社みずほ銀行 本店及び全国各支店

公 告 方 法 電子公告の方法により行います。但し、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本
経済新聞に掲載します。
公告掲載URL <https://www.towajapan.co.jp>



<https://www.towajapan.co.jp>

